

CINOS CLEANING TECHNOLOGY

Particle Oxide Combination

POC™



Oxidation



Changeless



Selective

CINOS

About

일반적인 반도체 공정에서 사용되는 제품을 세정하기 위한 기술로는 물리 및 화학적 방식을 통한 세정 방식을 적용하고 있으나 종래의 방식의 세정은 공정 부산물을 제거함과 동시에 모재 또한 식각, 변형되는 등의 문제를 야기시키며, 이는 제품의 수명이 단축되어 생산성을 저하시킵니다. 또한, 초미세 파티클의 경우 표면 장력 등에 의해 효과적인 제거가 어렵습니다.

POC™는 반응 부산물 및 초미세 파티클을 산화를 통해 성장된 산화막을 결합시켜 모재에서 분리시키고, 이후 성장된 산화막을 선택적으로 제거하여 기존 세정 대비 55% 개선되었으며 모재에 영향을 주지 않는 세정입니다.

Mechanism



Merit

POC™는 모재에 잔존한 초미세 Particle을 POC™ Film을 적용하여 모재 손상 없이 오염된 부분을 선택적으로 제거할 수 있습니다.

